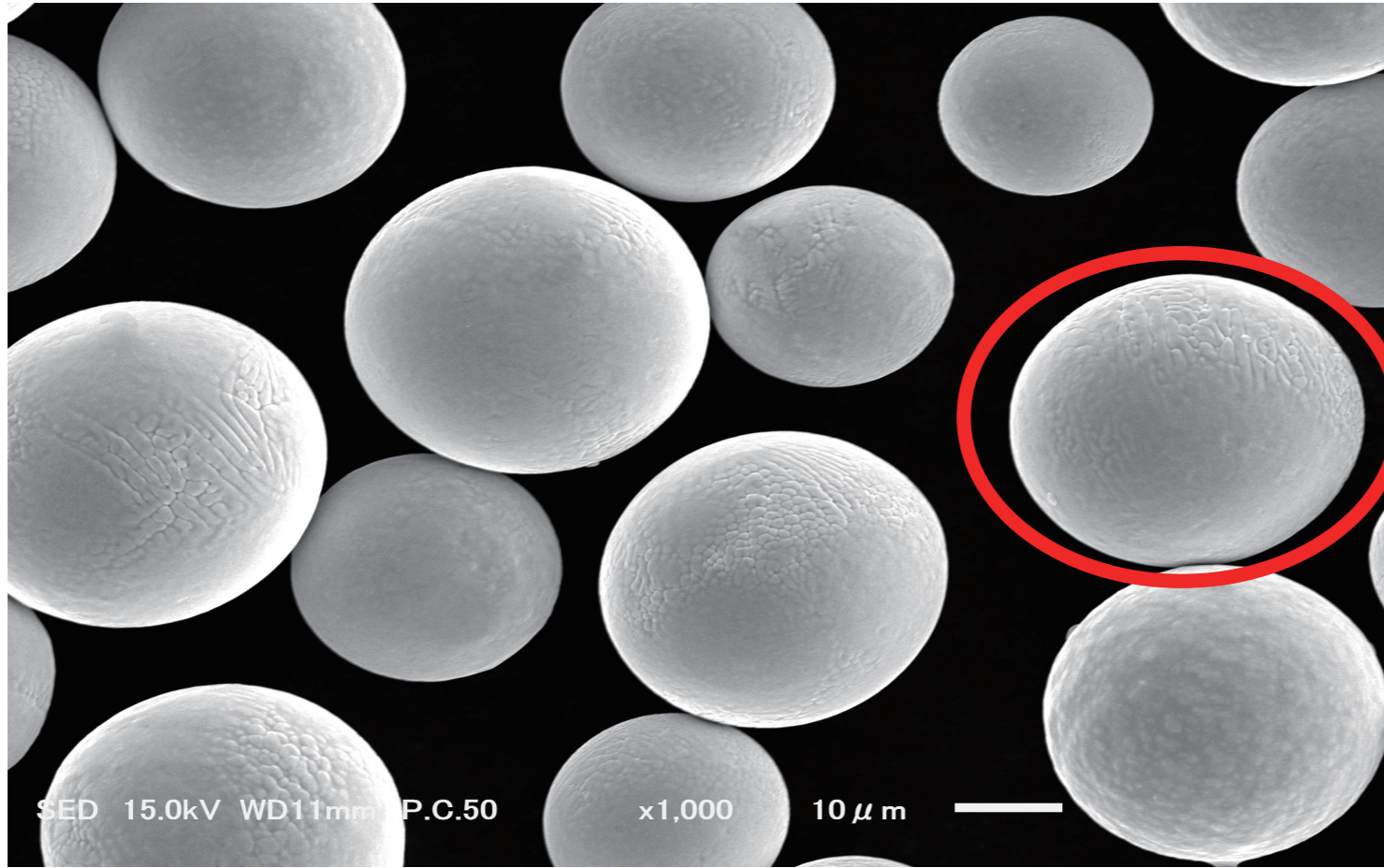


# 接合部の超微細化へ!

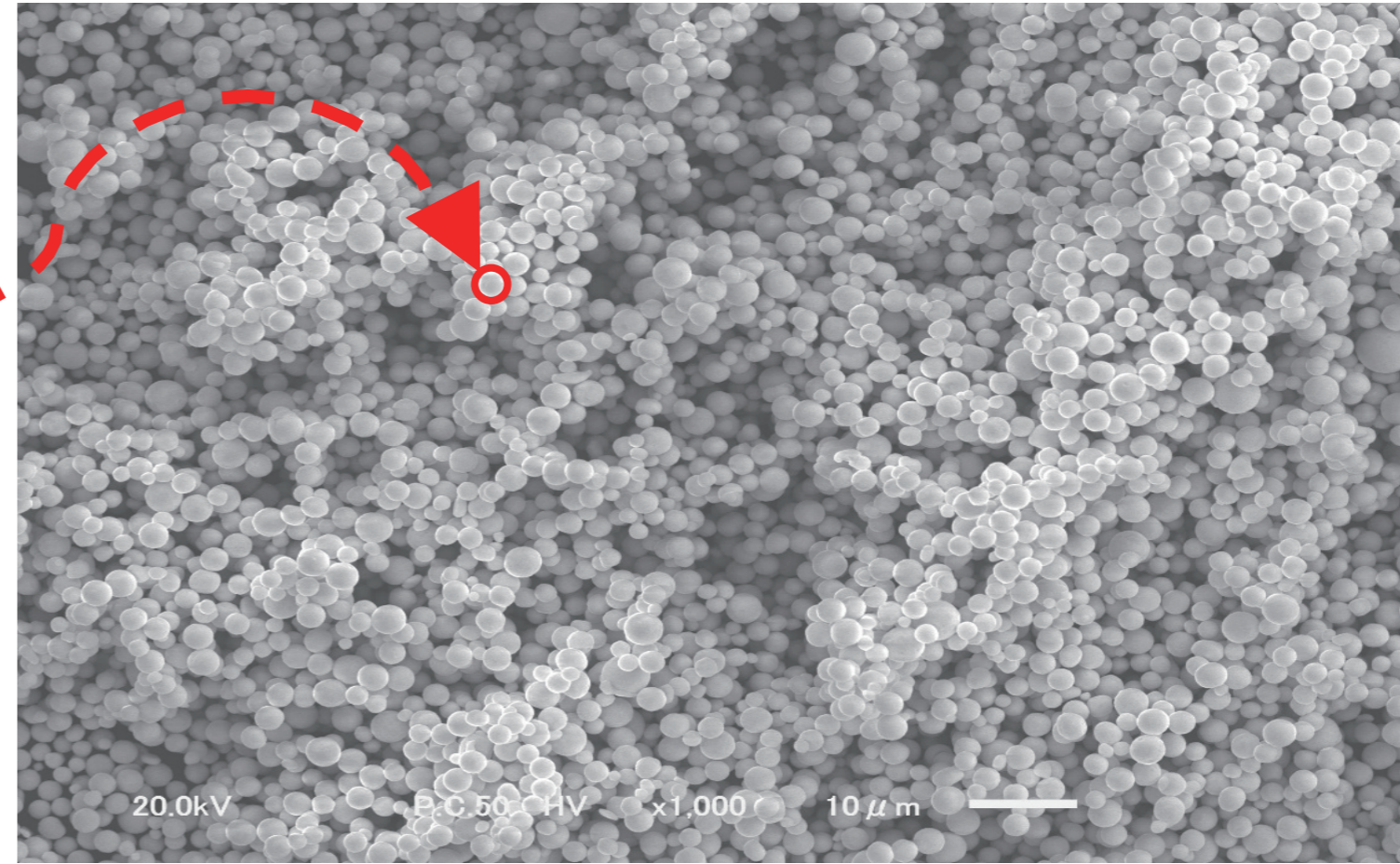
Toward Ultra-miniaturization of Joint!

## 超微細はんだ粉末Type9(1~5 $\mu$ m)適用製品

Products applied by Ultra-fine solder powder Type9 (1~5 $\mu$ m)



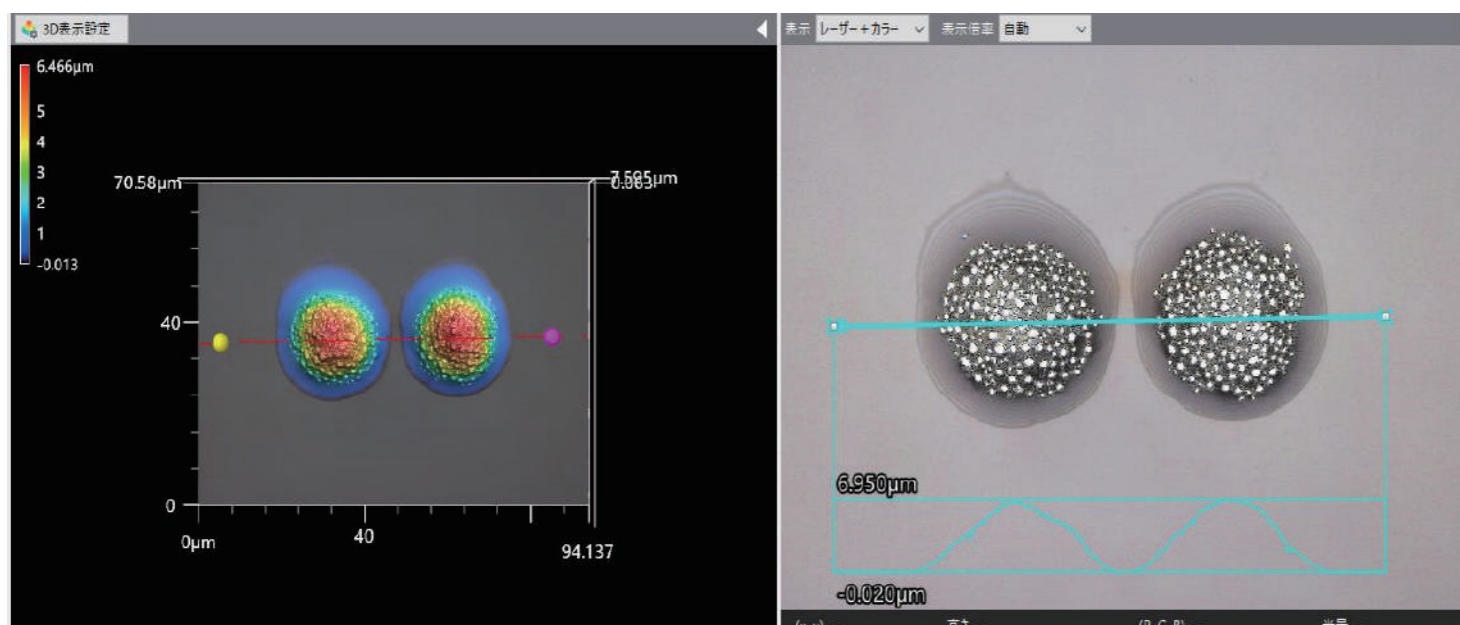
Type4:22-38 $\mu$ m



Type9:1-5 $\mu$ m

### NP303-UFP501-T9 (印刷用) (for printing)

極薄マスク、極小開口でのマスク印刷に適応  
Suitable for mask printing with ultra-thin masks and ultra-small apertures



開口(Aperture):15 $\mu$ m  
マスク厚(Thickness of Stencil):6 $\mu$ m

### NP303-DPF201-T9 (ディスペンス用) (for dispense)

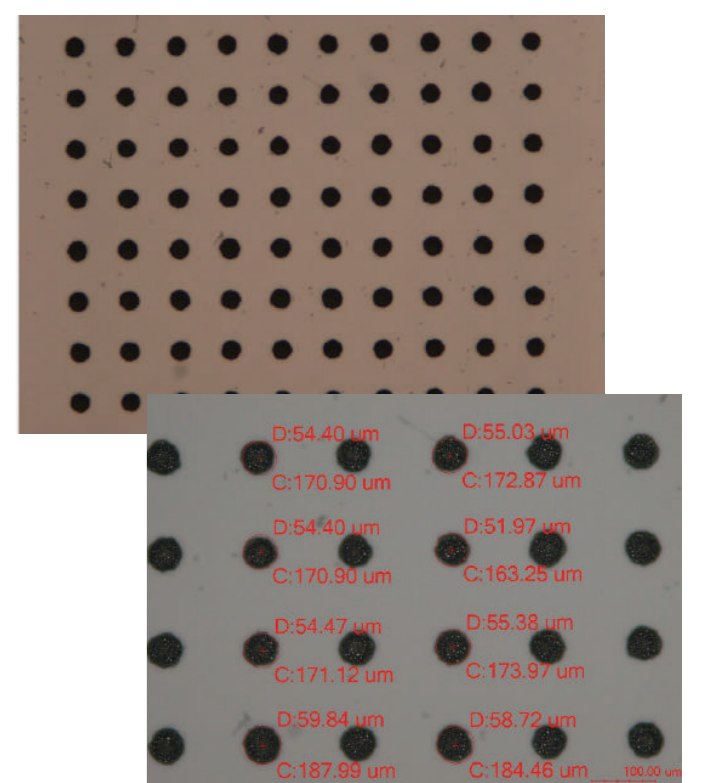
Twin-air方式により、  
 $\Phi$ 50 $\mu$ mサイズのディスペンス供給が可能  
Enable to dispense  $\Phi$ 50 $\mu$ m size by Twin-air system

#### 塗布試験結果

Test results of dispensing

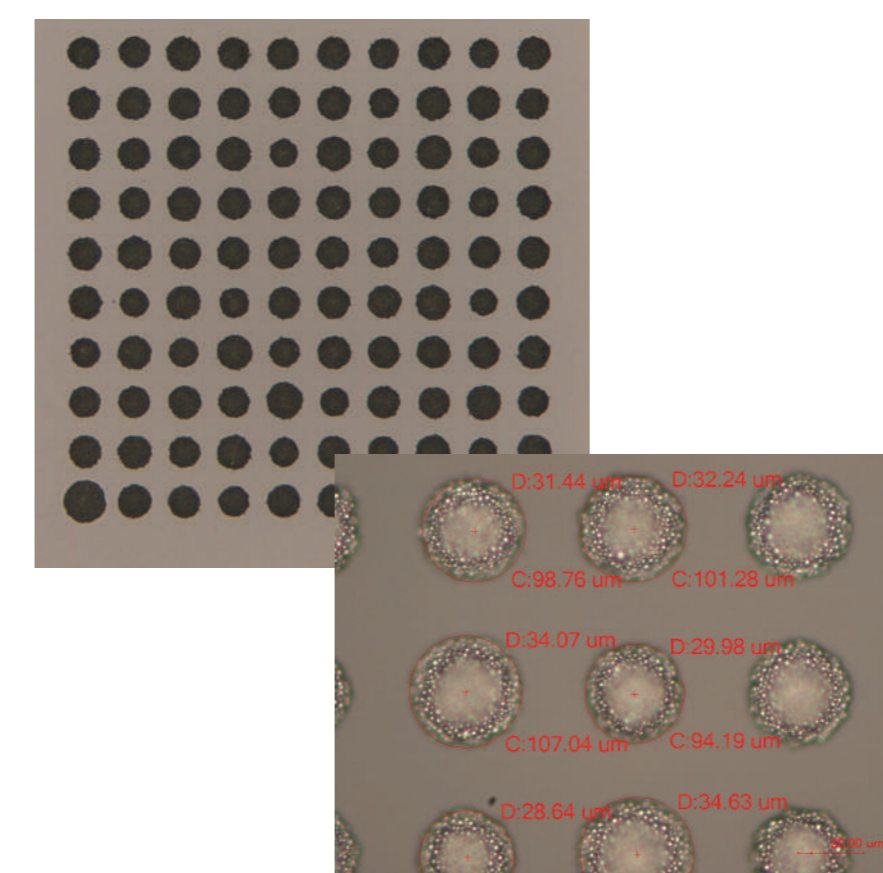
#### $\Phi$ 50 $\mu$ m塗布可能

$\Phi$ 50 $\mu$ m dispensing is possible



株式会社エンジニアリングラボ様のTwin-airディスペンサ搭載  
ESシリーズにより、 $\Phi$ 50 $\mu$ m塗布を実現可能に!

ES series with Twin-air dispenser from Engineering Lab Inc. enables  $\Phi$ 50 $\mu$ m dispensing!



ES10, 12

ES30

$\Phi$ 50 $\mu$ m以下も可能  
Possible under  $\Phi$ 50 $\mu$ m

※株式会社エンジニアリングラボ  
社製ディスペンス装置  
Dispensing equipment manufactured by  
Engineering Labs, Inc.

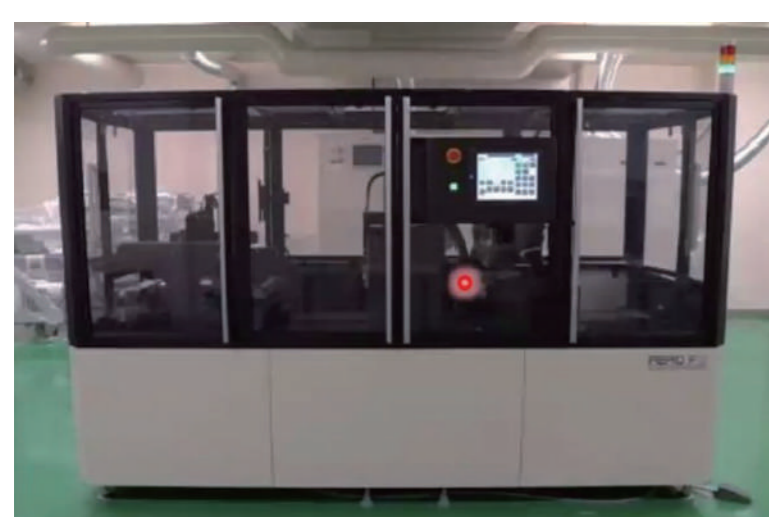
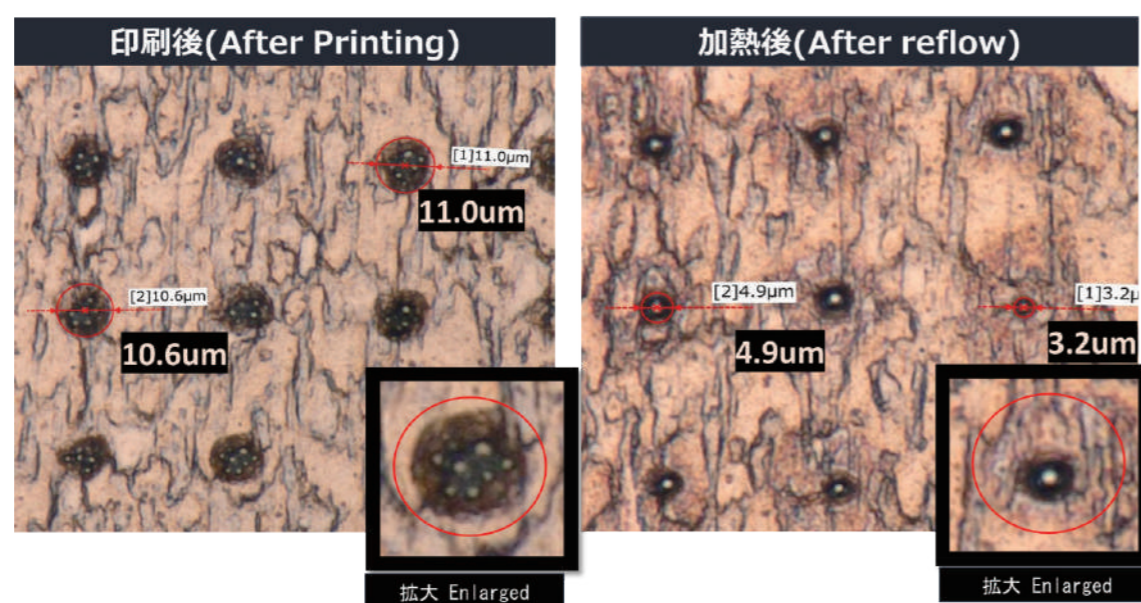
### NP303-GOP501-T9 (グラビアオフセット印刷用) (for gravure offset printing)

グラビアオフセット印刷により、  
 $\Phi$ 10 $\mu$ mサイズのはんだ印刷が可能

By gravure offset printing, solder printing of  $\Phi$ 10 $\mu$ m size is possible



銅基板上印刷、リフロー  
(Printing, Reflow on Copper  
substrate)  
Diameter/Pitch  
 $\Phi$ 10 $\mu$ m / 30 $\mu$ m



株式会社セリアコーポレーション様の  
グラビアオフセット印刷機により  
 $\Phi$ 10 $\mu$ m印刷を実現可能に

Gravure offset printer of Seria Corporation enable  $\Phi$ 10 $\mu$ m printing.

